

# 株式会社TMH

## 2026年11月期 第1四半期

### 連結決算補足資料

東証グロース市場 / 福証Q-Board市場：280A  
2026年4月14日

# 株主の皆さまへ

---



代表取締役社長  
**榎並 大輔**

半導体市場は、AIの進化、量子コンピュータ、IoTといった技術革新を牽引役に驚異的な成長を遂げており、あらゆる産業の競争力を左右する戦略的に重要な産業として、その存在感を一段と高めています。こうした中、世界中の半導体工場が稼働を続け、半導体製造装置の累積台数が増えるほど、当社が属する半導体製造アフターマーケット市場も着実に拡大していくと考えています。

当社は、エンジニアリングとデジタル化（プラットフォーム）の両面から半導体工場のサプライチェーンを支え、工場の安定稼働に貢献してまいりました。私たちは、**日本の半導体産業、ひいては日本のものづくりの復権に貢献するという強い使命感**を持って活動しています。半導体産業が日本の産業競争力を再び世界に示す原動力となるよう、挑戦を続けてまいります。今後とも、当社の挑戦と成長にご期待いただき、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

# AGENDA

## 01 2026年11月期1Q 業績ハイライト

02 中期経営計画サマリ ※2026年1月14日公表

03 事業概要

04 市場環境

05 競争優位性

Appendix

## エグゼクティブサマリ

1Qは8.1億円の売上、44.3百万円の営業損失。当期は下期偏重の計画で、現状は計画内で進捗

中古装置案件の多くの入札が上期後半以降に予定されており、  
受注残の積み増しは2Q以降を予定  
**結果として、業績も下期偏重の見込み**

2026年11月期 1Q実績					
	年度計画	1Q実績	進捗率	1Q	2-4Q見込み
売上高	6,112 百万円	814 百万円 (前年1Q実績 2,305 百万円)	13%	13%	87%
営業利益	367 百万円	▲44.3 百万円 (前年1Q実績 65.7 百万円)	—%	—%	100%
経常利益	369 百万円	▲44.9 百万円 (前年1Q実績 57.9 百万円)	—%	—%	100%

### ■ 2Q以降の事業進展見通し

- ・中古装置販売は、国内外で新規入札先が拡大、2Q後半以降で大型案件の受注積み上げ見込み
- ・部品販売・修理およびフィールドエンジニアリングサービスは、採用強化による体制強化を推進中
- ・M&Aは、複数の潜在案件を並走させつつ、専門人材を補充することにより新規ソーシングを強化

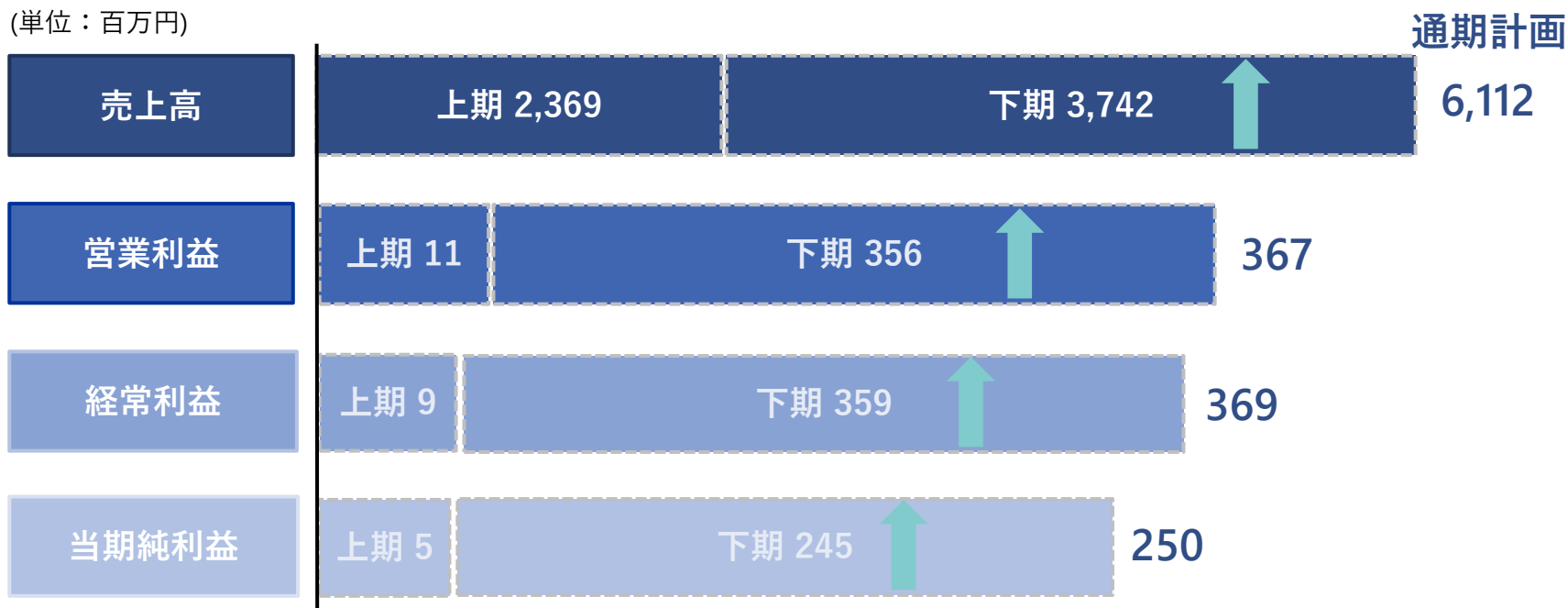
※2025年2Q以前は非連結のため、参考として単体数値を記載しております

## 上期・下期別の当期年度計画

当期は売上・利益ともに下期偏重の計画で、現状は計画内で進捗

通期計画に対し、上期は売上・利益ともに低調な滑り出しだが  
下期に中古装置の売上が偏重しているため、通期では計画通りに進捗見込み

(単位：百万円)



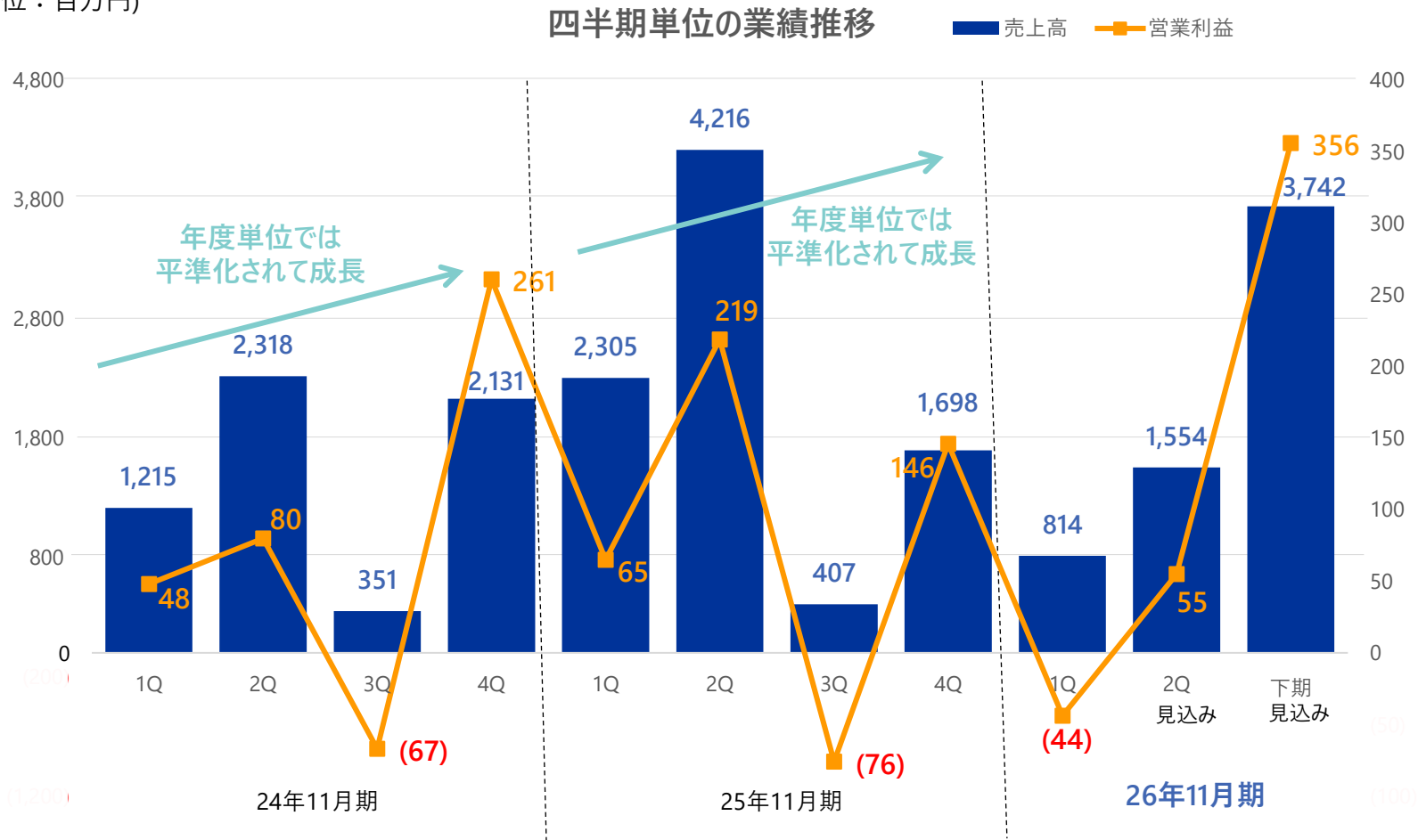
- 売上高** : 下期は中古装置の入札案件の増加により、売上が拡大見込み  
人員体制の強化・刷新により、部品・修理サービス案件も2Q以降で成長を見込む
- 営業利益** : 上期は将来成長に向けた積極採用に伴う採用エージェント費が増加  
下期は売上拡大に伴い利益増加
- 経常利益** : 上期・下期ともに営業外収支に大きな変動はなく、営業利益の動向に連動
- 当期純利益** : 上期は利益水準が低く税負担は限定的、下期は利益拡大に伴い税負担が増加

# 業績ボラティリティ

## 四半期単位でみると、売上・利益ともにボラティリティが高い傾向だが、年度単位では安定

装置販売ビジネスは、一案件当たりの売上単価が大きく、また売上が平準的ではない側面があり、装置販売ビジネスの売上構成比の高まり(約86%)により、四半期単位で売上・利益が平準化しない傾向

(単位：百万円)



# 1Qの事業トピックス

## グローバル販売力・技術力の強化

### 更なる販売強化・成長を目的として、中国に子会社を設立予定

#### 概要

- 中国（上海市）に子会社を設立予定（2026年6月予定）
  - ・中国国籍の社員複数名が現地に常駐予定



#### ■ 法人設立の狙い

- ①顧客深耕
  - ・エンドユーザーとの直接取引、現地での人脈構築・ホットライン構築
  - これにより、利益率の向上、中国市場における競争優位性の強化、ならびに資金回収力の強化を図る
- ②新規ビジネス構築
  - ・将来的に、現地における半導体関連材料/部品などの製造・加工・販売も検討

#### ①顧客深耕

仲介会社を通さずエンドユーザーへ直接販売

<中国法人設立前>

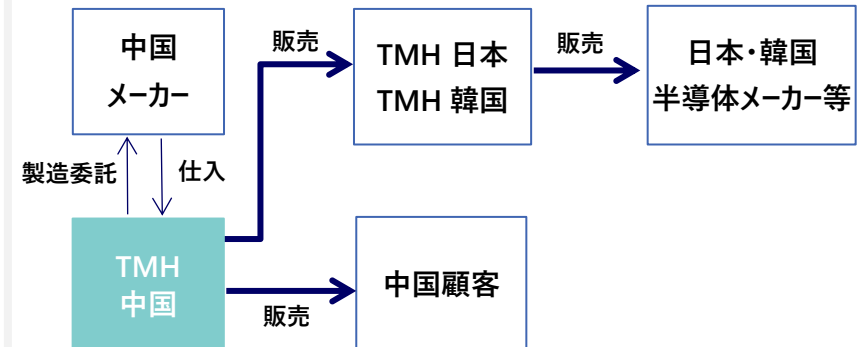


<中国法人設立後>



#### ②新規ビジネス構築

中国の補助金及び生産体制・基盤を利用して、日本等へ販売し、サプライチェーンを強化



## KPI（事業）

1 QはYoYで各指標が減少したものの、受注積み上げを背景に通期では業績回復を見込む

受注残はYoYで減少の一方、日本・韓国ともに2 Q以降の入札案件を複数予定  
当期の業績に寄与する案件を着実に積み上げ、受注拡大を見込む

(単位：百万円)

KPI		2025年11月期 1 Q末 ※	2026年11月期 1 Q末	YoY 増減率
未来の業績に関する指標	装置販売サービス 受注残総額	4,324	1,095	-75%
過去の業績傾向に関する指標 (累計)	(越境ECプラットフォーム) 部品販売・修理サービス売上高	247	211	-15%
	(エンジニアリング) 装置販売サービス売上高	2,057	603	-71%
生産性に関する指標 (売上高・純利益は累計)	従業員一人当たり売上高	59	17	-71%
	従業員一人当たり純利益	1.0	▲0.6	-

※2025年1Qは非連結のため、参考として単体数値を記載しております

受注残とは受注契約から将来に期待される収益の総額を意味しております。つまり、受注残が積みあがることは将来の業績への寄与が見込まれることとなります

# 連結貸借対照表

## 前受金を除く実質的な自己資本比率は60.2%、高い財務安全性を継続

(単位：百万円)

### 資産の部

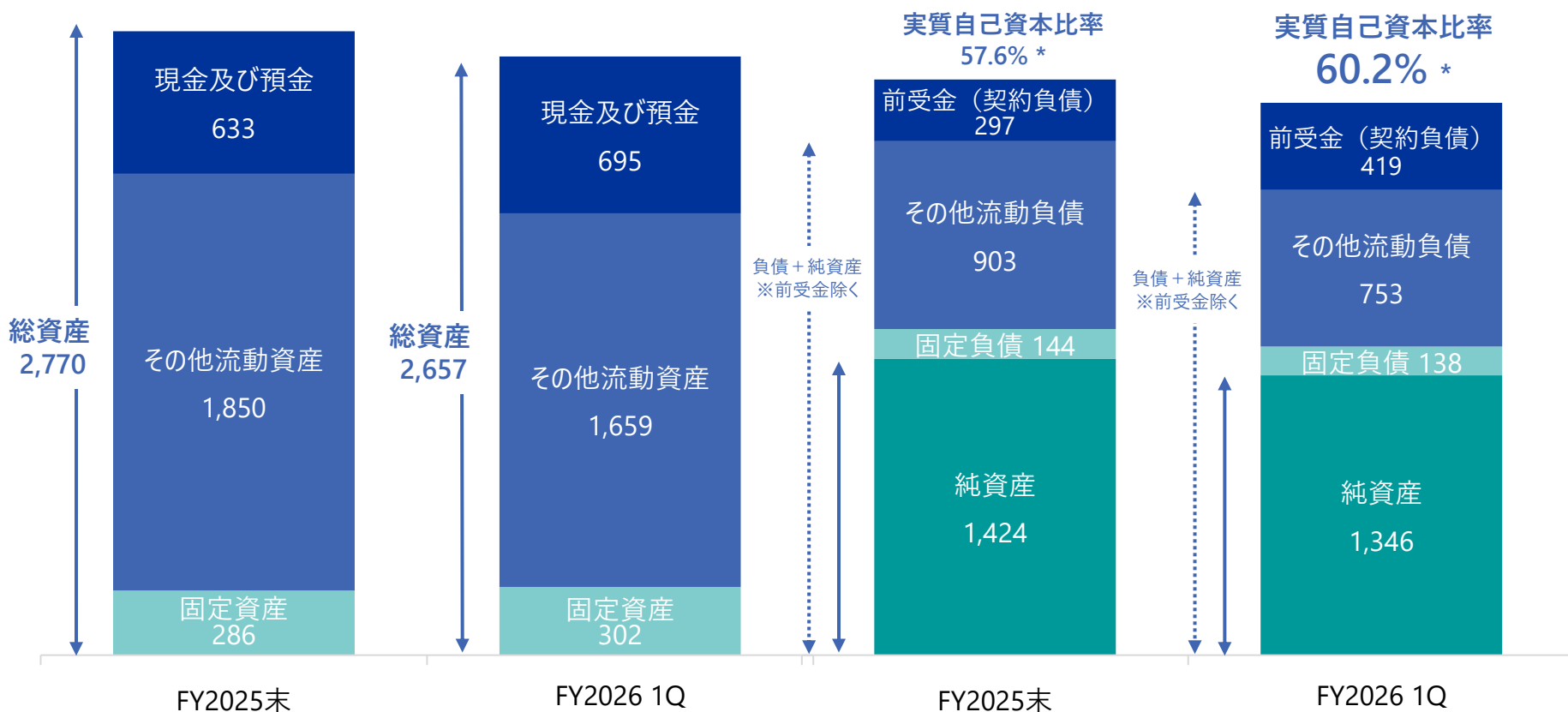
現金及び預金：前受金の受取により増加

その他流動資産：売掛金の回収、売上に伴う在庫の減少

### 負債・純資産の部

前受金（契約負債）：装置案件の受注により増加

純資産：自己株式の取得、四半期純損失により減少



\*前受金（契約負債）控除後の自己資本比率

## 中長期的目線でのFY2026の位置づけ

### FY2026は「次なる成長ステージへの助走期間」

短期的な市場変動に対応しつつ、中長期的な飛躍を見据えた戦略的投資を実行

	FY2026	中長期
既存事業	<b>装置販売事業のサイクル</b> 不確定要素による一時的な調整局面 △ 踊り場	○
	<b>ECプラットフォームの伸長</b> 継続的な高成長（CAGR +20%超） ○ 成長継続	○

短期的な市場周期影響に対応しつつ、中長期的な成長を見据えた投資を実施

新規展開	<b>装置代理店ビジネス</b> 半導体製造装置メーカーとの代理店ビジネスの開始や、SEMICON.TODAYをはじめとしたプラットフォーム拡張に取り組む。FY2026への業績影響は限定的であるが、既に事業の柱となる目途が立っており、中長期的には重要な成長ドライバーとなる ○ 立ち上げ	◎
	<b>海外展開</b> 海外展開の加速化に伴い、初期投資に関するコストが先行発生 ○ 投資先行	◎
	<b>M&amp;Aグロース</b> M&A戦略のためプロジェクトチーム立ち上げ、FY2026より専門家費用等、検討フェーズに係る費用の先行発生 △～○ 投資先行	◎

# AGENDA

01 2026年11月期1Q 業績ハイライト

**02 中期経営計画サマリ ※2026年1月14日公表**

03 事業概要

04 市場環境

05 競争優位性

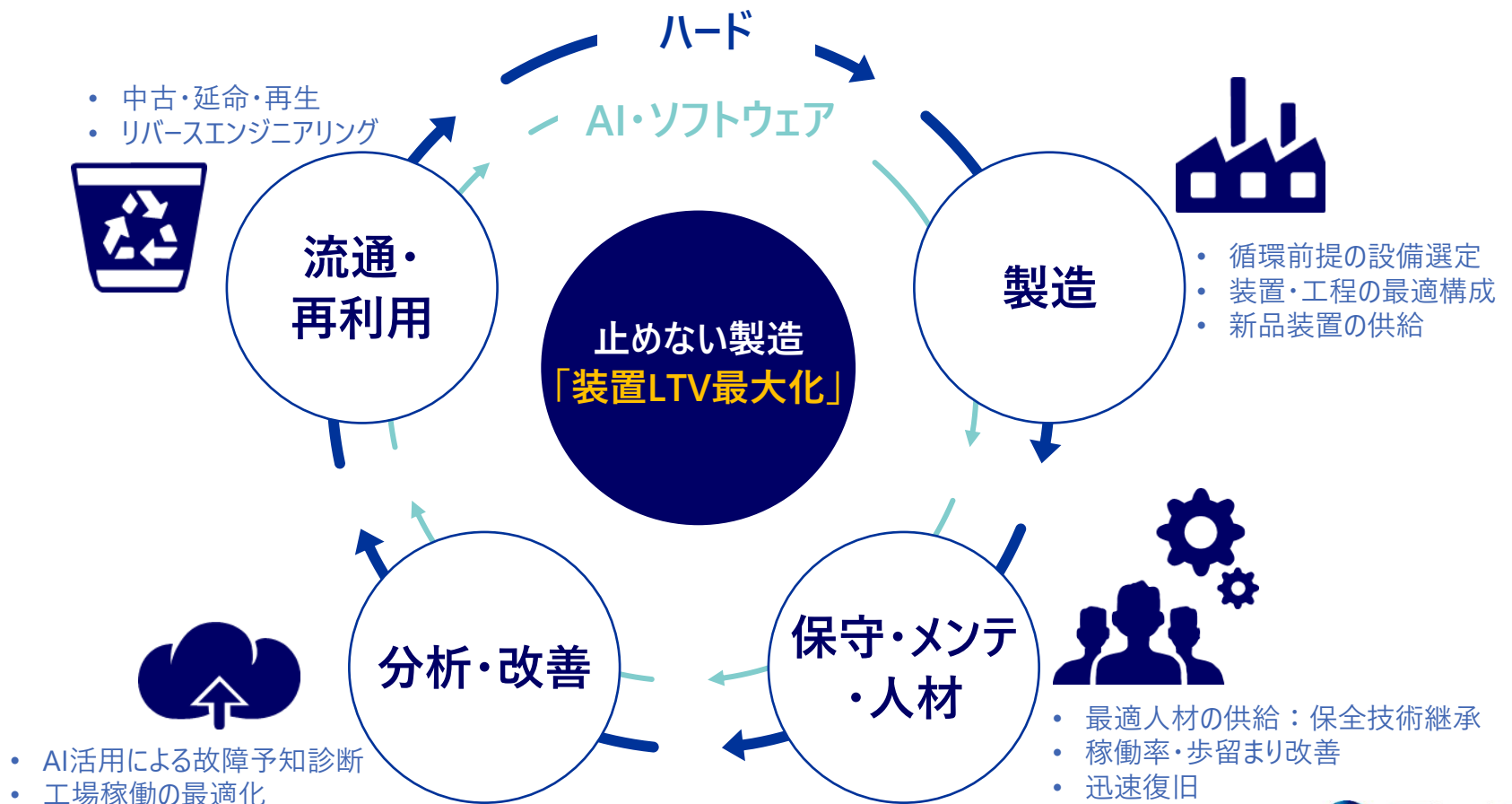
Appendix

# 当社の考える 未来の半導体製造サプライチェーン

## 「循環型」ビジネスを前提とした、効率性の高いサプライチェーンが重視されるモデルへ

- 資源枯渇、紛争・分断など不確定要素が高まる社会では、「**止めない製造**」を実現するための**循環設計**が重要視
- 「故障予知により稼働を止めない」、「稼働率・歩留まり・人材定着まで含めた価値提供」、新品前提から「循環型」へ

### 循環設計



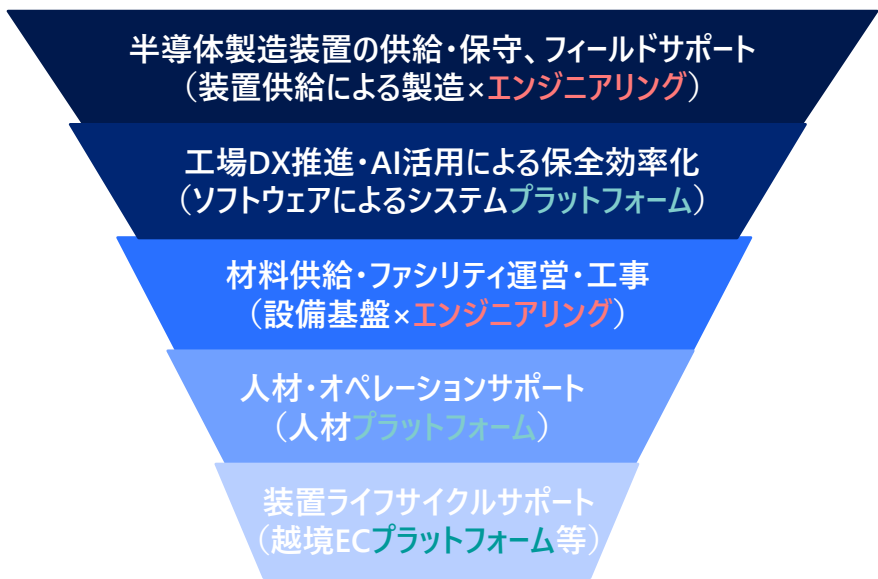
# 中長期目標 Vision1000

当社は、中長期的に売上高1000億円規模の企業体への成長を目指す

TMHは、アフターサービスを担う装置ライフサイクルサポートから、仕組みとシステムによるプラットフォームを通じて半導体製造を統合的に支援する「半導体製造インテグレーター」へと進化する

## Vision1000

半導体製造インテグレーターへ  
工場の多様な課題を**エンジニアリング**×**プラットフォーム**により解決



製造	サービス : 工場全体の運営受託、生産性改善・コスト最適化の請負契約 収益モデル : 工場運営全体の包括契約、高付加価値モデル
DX・AI予知保全	サービス : DX推進/AI活用により、半導体工場のレガシーシステムの改善・刷新 収益モデル : SaaSモデル、ソフトウェア利益率による高収益化
材料供給 ファシリティ管理 工事	サービス : 薬液・ガス供給の安定運用、純水・空調・廃棄処理など工場インフラ管理、工事 収益モデル : ストック型収益 + 高収益率
人材・ オペレーションサポート	サービス : 人材プラットフォームサービス、エンジニア教育・研修プログラム 収益モデル : 継続契約化 (準ストック型)
装置ライフサイクル サポート	サービス : 越境ECを活用した部品販売・修理サービス、エンジニアリング力を活かした装置販売、その他付帯エンジニアリングサービス 収益モデル : 単発取引あり、一部準ストック型

ホワイトスペースを埋めていくことが、半導体工場の稼働継続に必要な要件を充足

### 「止めない製造」の実現へ

# Vision1000 ロードマップ

## アフターサービス企業から“半導体製造インテグレーター”へ！売上高1,000億円へのロードマップ

オーガニック成長を加速させるとともに、インオーガニック成長への施策に取り組み、Vision1000の達成へ

~2025年11月期

2026年11月期~2028年11月期

203X年

### Phase 1

売上高 86億円  
営業利益 3.5億円

### Phase 2

売上高\* 180億円  
営業利益 17.6億円

### Phase 3

売上高\* 1,000億円  
営業利益 150億円

### 半導体工場の ライフサイクルサポート事業確立

- ・ LAYLA顧客基盤の確立
- ・ 装置販売サービスの拡大
- ・ プラットフォーム力、エンジニアリング力の強み確立

#### ①代理店ビジネス開始

代理店事業等、既存の強みを活かした周辺事業の開拓

#### ②ホワイトスペースM&A

半導体分野におけるホワイトスペースへの能動的M&A

#### ③プラットフォーム拡充

LAYLA-HR、SEMICON.TODAY等、プラットフォームの拡充

#### ④グローバル展開加速

海外投資による販売・調達ルートの拡大

中期  
180

Vision  
1000

中期施策を磨き上げ、  
オーガニック×インオーガニック  
で更なる成長へ！

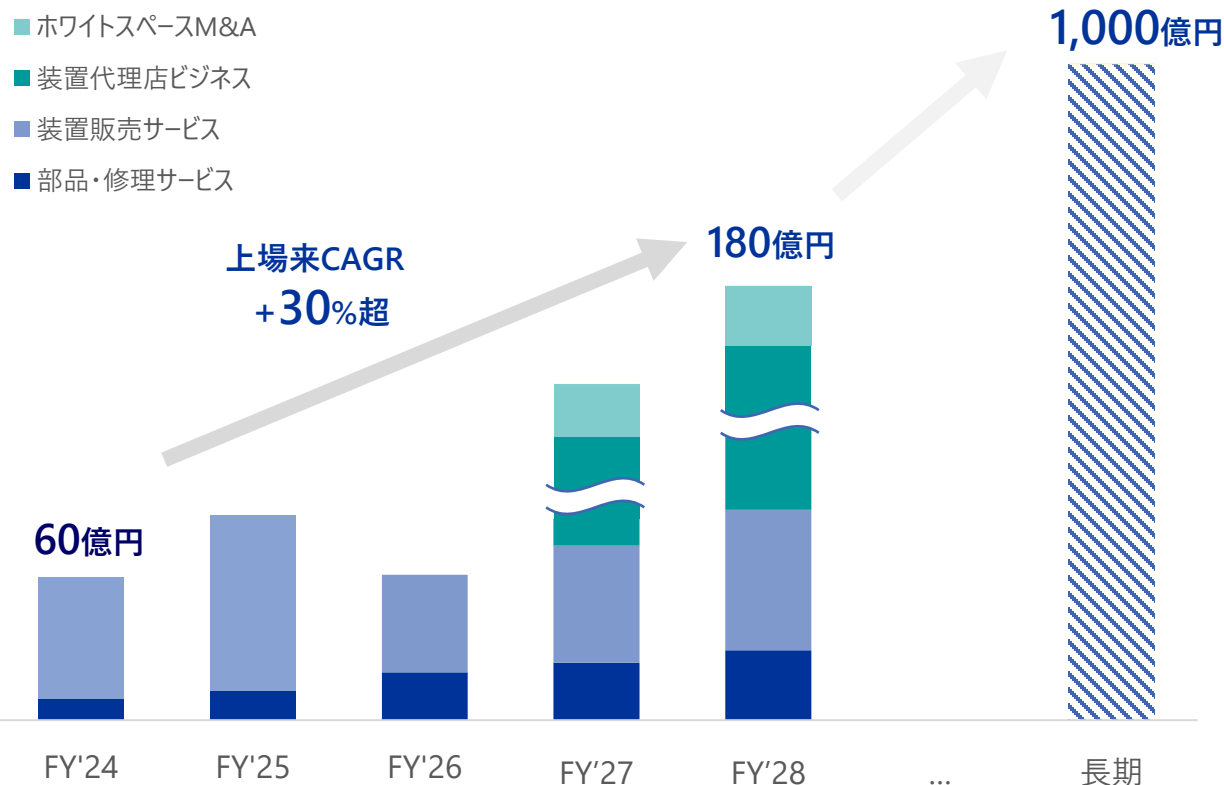
\*売上高については流通総額の情報として記載しております。

## 中長期成長イメージ（売上高）

代理店とM&Aでポートフォリオを広げ、中長期で売上高1,000億円への成長を目指す

- 中長期的には**代理店ビジネス**、**ホワイトスペースM&A**を成長ドライバーに加え、更なる成長を図る
- 半導体装置の代理店は単なる仲介業者に留まらず、各装置メーカーの国内におけるいわば“顔”の役割  
当社のプラットフォーム力・エンジニアリング力の発揮、強化により既存事業とのシナジーを創出

### 売上高（流通総額）推移



#### ホワイトスペースM&A

当期より取り組みを始めたM&Aに関して、本中計期間中の実行に向けて進捗中長期のトップラインを押し上げ

#### 代理店ビジネス

韓国装置メーカーと、国内取扱における独占代理店契約締結

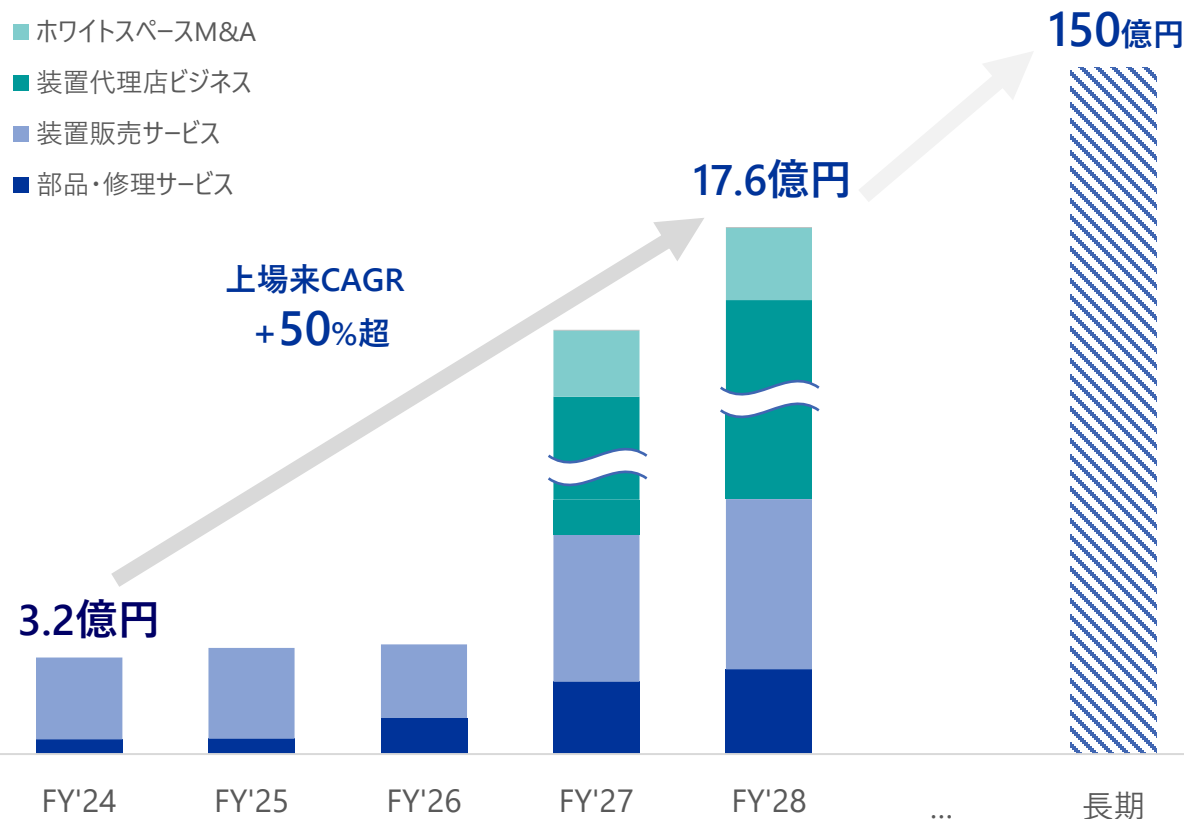
既にFY2027の売上につながる具体的な引き合いがあり、**1台3億円以上×年間数台～数十台の受注確度高**

## 中長期成長イメージ（営業利益）

高利益事業の成長と収益構造の進化により、営業利益150億円の達成を目指す

- 装置代理店ビジネス、ホワイトスペースM&Aを成長ドライバーに加え、更なる成長を図る
- 利益効率の高い装置代理店ビジネスの成長、増収に伴う固定費率の縮小により  
**営業利益は上場来CAGR+50%超へ**

### 営業利益推移



#### 装置代理店ビジネスの 高い利益効率

既存の装置販売事業と比して高い利益率の確保が可能、さらなる利益拡大を見込む

#### 増収レバレッジ効果

大幅な増収・固定費率の縮小により利益拡大

# FY2026計画および中期計画

FY2026は増益を確保し、FY2028には営業利益17.6億円への飛躍的な拡大を目指す

- 装置販売サービスの不確定要素により、FY2026は減収を見込むが、高収益案件及びECの伸長により増益予想
- 中期的には新規事業である装置代理店ビジネスの拡大およびホワイトスペースM&A、これらのシナジー効果により **営業利益17.6億円**を見込む

CAGR (単位：百万円)

	FY2025 実績	FY2026 計画	FY2027 計画	FY2028 計画	FY2028 -FY2025比 (増減率)
売上高	8,628	6,112	10,336	<b>12,805</b>	+4,176 (+48.4%)
売上高 (流通総額) *	8,628	6,112	14,153	<b>18,291</b>	+9,662 (+112.0%)
売上総利益	970	1,002	2,967	<b>3,457</b>	+2,486 (+256.3%)
(売上総利益率)	11.2%	16.4%	28.7%	<b>27.0%</b>	+15.8pt
営業利益	355	367	1,421	<b>1,767</b>	+1,411 (+396.9%)
(営業利益率)	4.1%	6.0%	13.8%	<b>13.8%</b>	+9.7pt

\* 装置代理店ビジネスのうち、財務諸表上の売上高と売上原価が純額計上となるものを、総額計上とした場合の数値

# AGENDA

- 01 2026年11月期1Q 業績ハイライト
  - 02 中期経営計画サマリ ※2026年1月14日公表
  - 03 事業概要**
  - 04 市場環境
  - 05 競争優位性
- Appendix



株式会社TMHは、Technology Makes Happinessの  
頭文字から社名が構成されています。

### MISSION

先端技術で豊かな社会を創ること

### VISION

最高のバリューを提供し続けること

## 会社概要

会社名	株式会社TMH
代表取締役社長	榎並 大輔
所在地	大分県大分市下郡北3-14-6
設立	2012年3月9日
従業員数	46名（2026年2月末時点、連結ベース）
資本金	2億9909万円（2026年2月末時点）
事業内容	半導体製造フィールドソリューション事業 （装置・部品の販売・修理、越境ECサイト LAYLA-ECの運営）
事業所	大分本社・中部支店・関東支店 ・東北出張所・九州支店（熊本）
海外子会社	1社（大韓民国 平澤市）

国内 **5拠点 + 韓国** に展開



## マネジメントチーム

### 半導体製造装置の専門家が不足するなか、半導体・サプライチェーンの専門家にて構成



**榎並大輔 Taisuke Enami**  
代表取締役  
CEO

早稲田大学卒業後、株式会社東芝に入社。  
東芝在籍中にサプライヤー管理に課題を感じ独立。  
創業以来連続増収を実現。  
2020年には大分県から地域牽引企業として選定



**香月賢一 Kenichi Katsuki**  
取締役 CPO

株式会社東芝入社後、20年以上購買・調達に従事。2012年には東芝本社調達部の集約部材に配属。年間数十億円のコストダウンや改善を実現。2016年にTMHに参画



**関真希 Maki Seki**  
取締役 CFO

大手事業会社、デロイト・トーマツコンサルティング社にて経営改革に従事。グローバルコスト構造の可視化、M&A等サプライチェーン観点から多数のプロジェクトに従事。2015年にTMHに参画

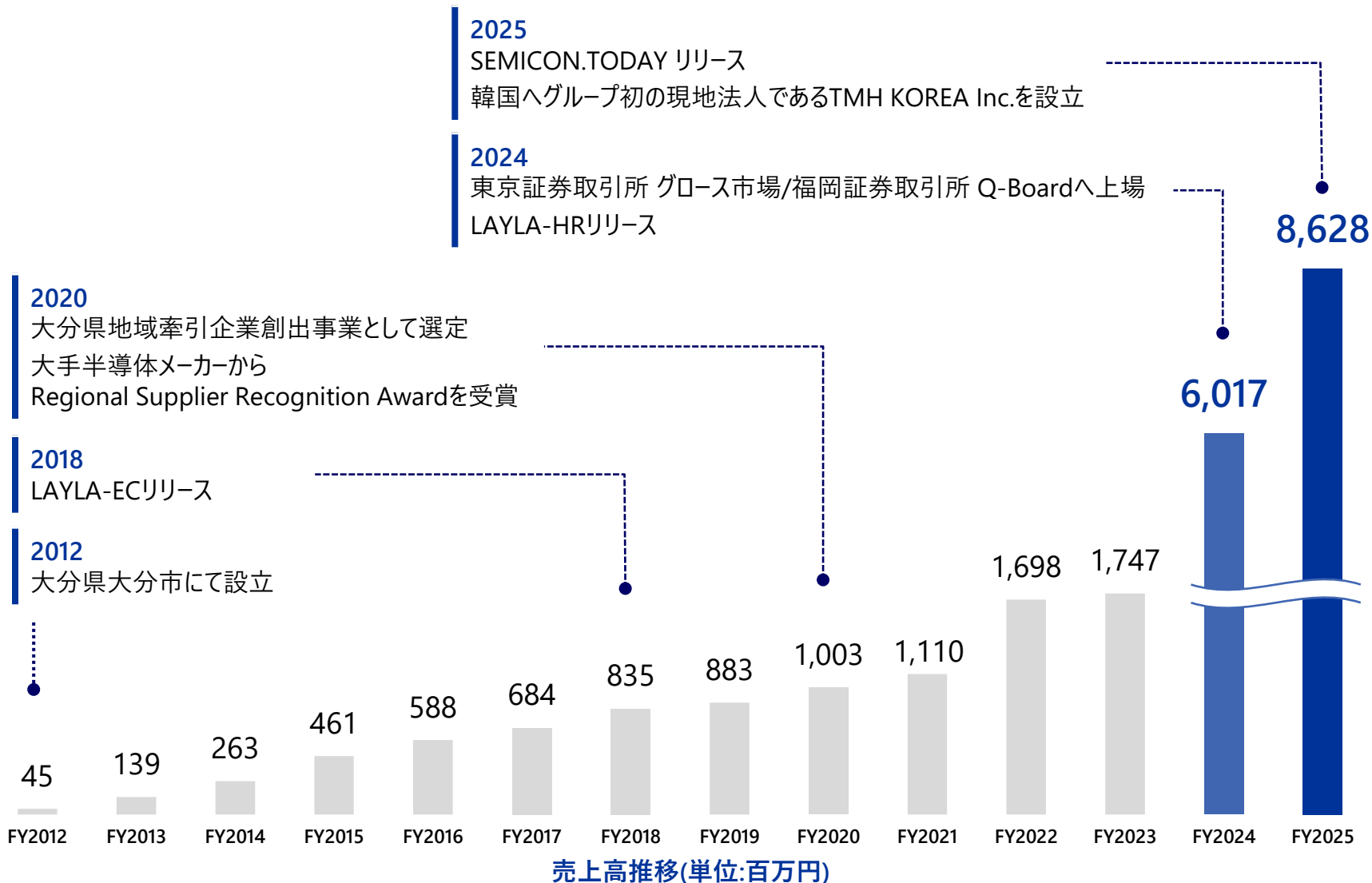


**野木村修 Osamu Nogimura**  
社外取締役

名古屋大学卒業後、日立製作所に入社。  
ルネサステクノロジ生産本部長、ルネサスエレクトロニクス執行役員  
生産本部本部長、ルネサスセミコンダクターパッケージ&テストソリューションズ  
代表取締役社長を歴任。一貫して半導体製造部門に従事

# 沿革

## LAYLAプラットフォーム、装置販売事業の拡大により設立から継続して成長



## 会社紹介

半導体市場において半導体工場の稼働を様々なかたちで支援するリーディングカンパニー



# 半導体業界が直面する様々な社会課題を解決する リーディングカンパニー

### 領域

巨大な  
半導体業界

### 提供する価値

半導体製造装置の延命  
メンテナンスコストの軽減

### 特徴

ニッチトップ  
かつ  
高成長

## 当社が必要とされる背景

老朽化した半導体工場には、多様なサプライチェーン課題が山積した状態

### 調達課題

- 日本の工場の多くは**陳腐化・老朽化が進み**、**レガシー半導体製造装置**が多く、**部品の調達が困難**
- レガシー半導体製造装置部品の調達は、属人的な調達手法が中心（**デジタル化の遅れ**）

### 製造課題

- IoT（Internet of Things）により急速な需要の高まりにより、**旧型装置の需要が継続**
- 長期的な国内半導体市場の低迷により、**エンジニア人材が枯渇**
- レガシー半導体工場では**設備保全の属人化が常態化**、装置トラブルが品質問題や大規模な納期遅延に発展

### 物流課題

- 部品取りのために購入した**旧型装置の保管が常態化**することで**生産スペースを圧迫**

## 当社が目指す未来

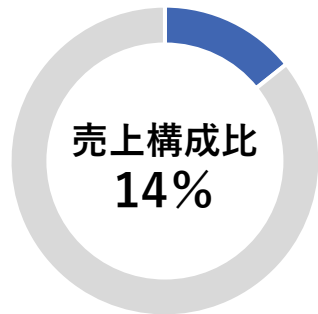
半導体製造に関する多様な課題を解決し、  
日本のものづくりの復権を支えます

# 事業内容 ～半導体製造フィールドソリューション事業の概要～ トータルソリューションの提供により、半導体工場の稼働を支援

## 半導体工場へのトータルソリューションサービスを提供

### 越境ECプラットフォーム等を利用した部品販売・修理サービス

#### 世界中の半導体製造装置・部品の売買にプラットフォームを活用



##### 【サービス内容】

- ✓ 希少部品の供給
- ✓ 幅広い修理サービスの提供

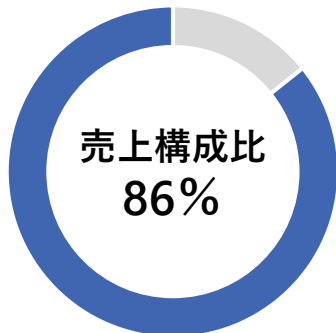
##### 【実績】

- ✓ 200社超の優良なグローバルサプライヤー（多種多様なメンテナンスや部品供給）
- ✓ 39.4万点超のアイテム数、50%超の国内半導体工場が導入済み



### エンジニアリング力を活用した装置販売サービス

#### 装置解体、移設、搬出、プロセスチューニング、立上げサービスを提供



##### 【サービス内容】

- ✓ 専門性が必要な装置の解体から搬出まで一気通貫でのサービス提供
- ✓ 旧型装置のプロセスチューニングによる歩留まりの改善

##### 【実績】

- ✓ 大手米国半導体メーカーからサプライヤーアワード受賞
- ✓ 過去の実績を持つ信頼性（半導体製造装置の取引、100台超）

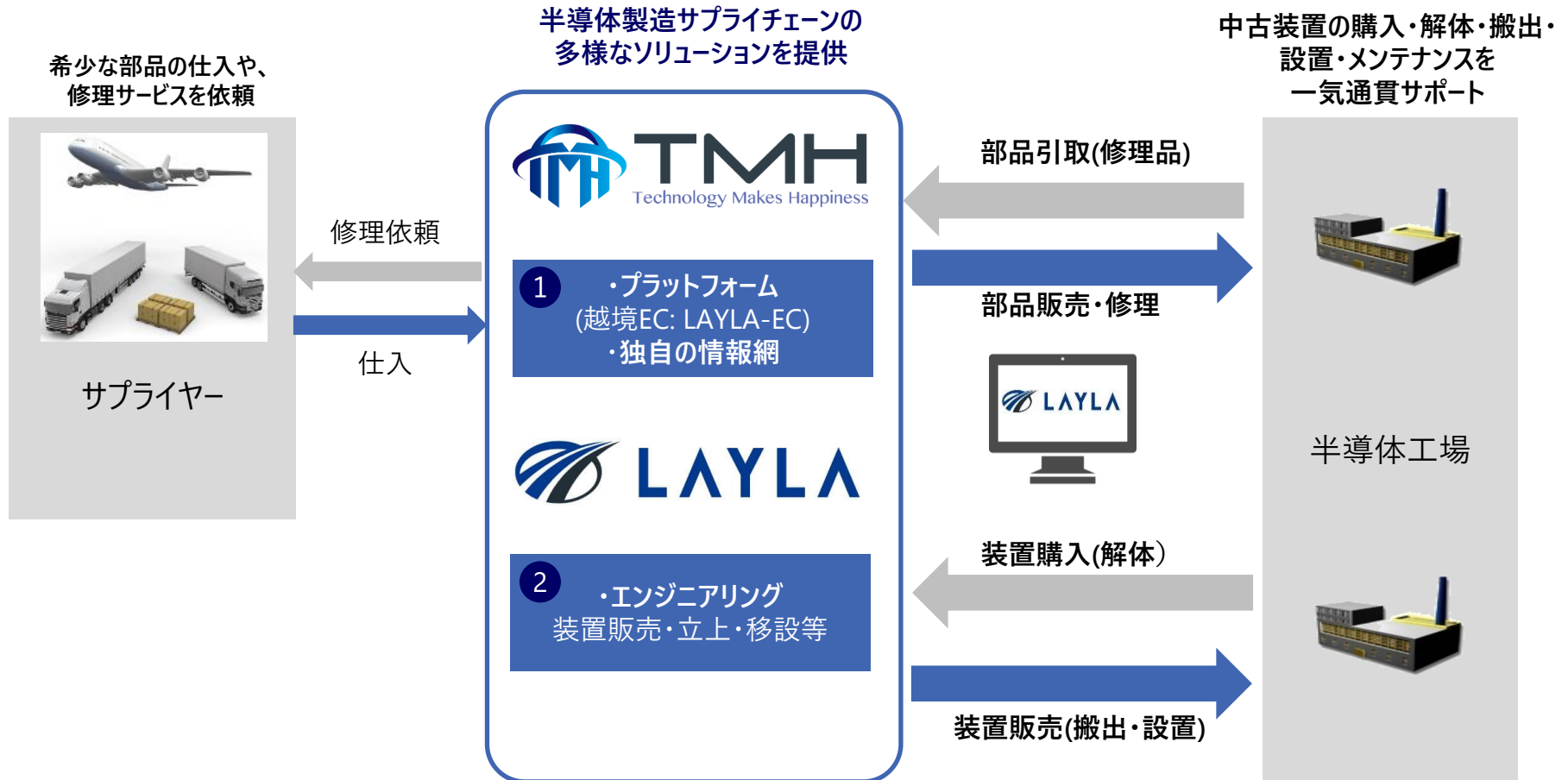


売上構成比は2025年11月期実績

# ビジネスフロー

## ECプラットフォームとエンジニアリングを融合し、半導体工場の持続的な稼働を支援

- 世界中のエンジニアリング会社やサプライヤーと協業し、部品の修理や販売、歩留まりの改善、不要装置・部品の買取など、お客様の課題に対して幅広いソリューションを提供
- LAYLAでは世界中の装置・部品のデータを集積し、半導体製造装置の調達プロセスを効率化  
半導体工場における半導体製造装置の効率的な運用と持続可能性に貢献

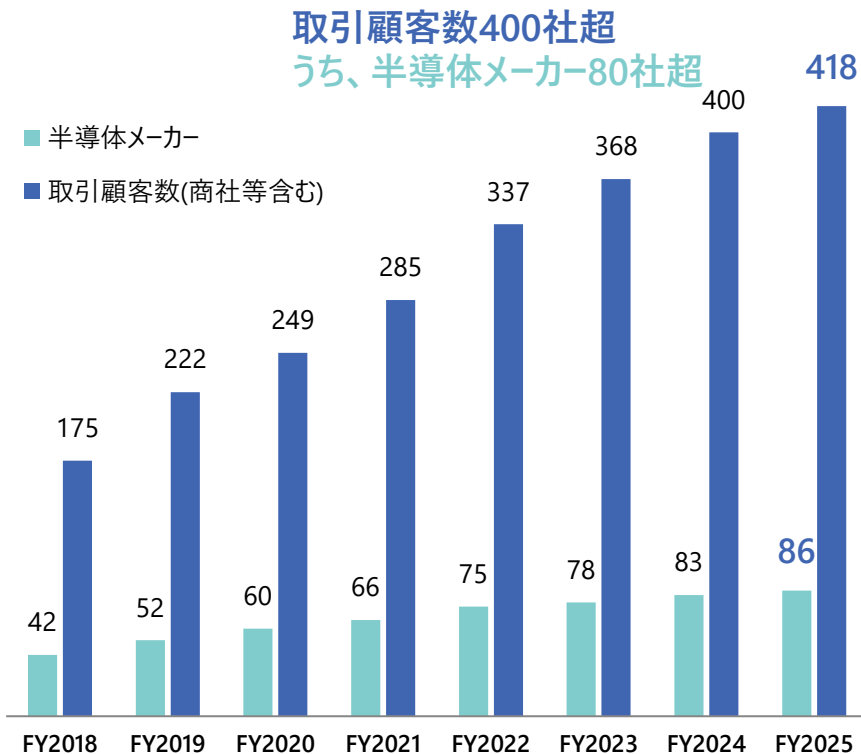


# 顧客

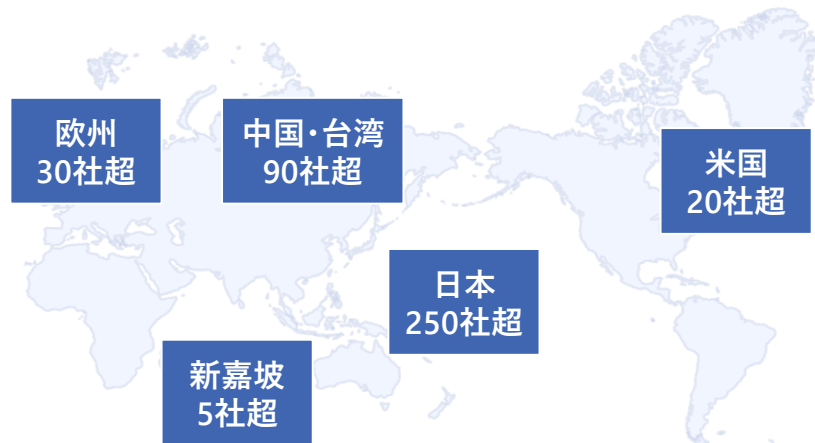
越境ECサイトを活用した圧倒的な調達力により、国内の半導体メーカーとの直接取引を拡大

- 国内ほぼすべての半導体メーカーと直接取引口座を開設済み
- 顧客のうち半導体メーカーは80拠点超。その他顧客も含めて全ての取引顧客数で300社超
- LAYLA-ECの展開により、海外半導体メーカーとの取引も拡大

## 顧客数推移



## 国別クライアントマップ



## 主な取引実績

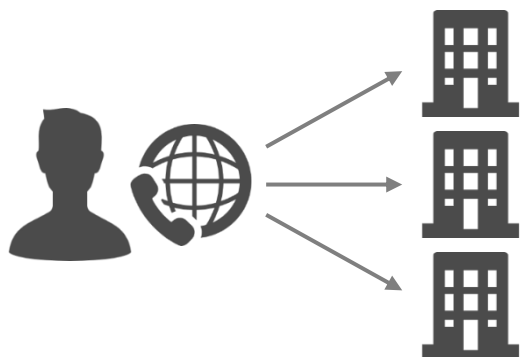
- キオクシア
- テキサスインスツルメンツ
- ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング
- ルネサスエレクトロニクス
- SUMCOグループ
- 東芝グループ
- ラピス 他

# LAYLAが提供する価値

## 世界中の実在庫が可視化できるプラットフォームを確立

- 従来の調達方法では困難だった実在庫の可視化を実現し、  
半導体製造装置の調達活動を効率化できるプラットフォームを提供

### 従来の調達方法



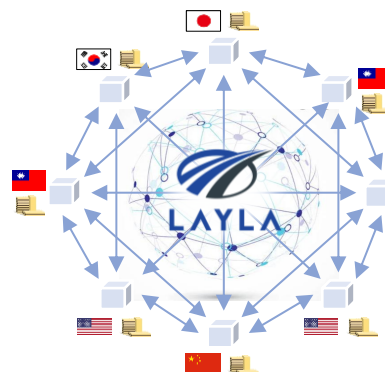
- 調達担当者が、必要な情報を各社に個別で問い合わせなければならないため、**必要な情報が限定される**
- 従来の調達方法では納品まで、**時間、コストがかかりすぎる**
- 調達ルートが限定されてしまうため、**独自に調達ネットワークを確立する必要がある**

老朽化した製造装置の部品調達が困難



### LAYLA

商品数**39.4**万点超



世界中の  
点在している  
部品を集約

- **実在庫を24時間365日確認可能**
- 可視化された実在庫の**価格、納期、保証期間、状態まで確認可能**
- TMHが販売窓口として機能するため、エンドユーザーが安心して購入できる環境を実現(安心保証)

半導体工場のDX化に貢献

# ビジネスフロー 装置売買プロセス

## 装置売買の前提となる解体作業ノウハウが当社にあることが売買加速に

- 装置売買において最も重要となる解体工程を内製化。  
高度なエンジニアリング力により迅速かつ信頼性の高い取引を実現



装置解体工程は極めて複雑であり、高度なエンジニアリング力が不可欠

### 無害化

ガスラインの遮断と排除  
冷却液や他の流体の安全  
な排除



### 停止処理

装置からの電源切断  
バックアップバッテリーの除  
去



### 配線除去

外部カバーの取り外し  
配管やケーブルの取り外し



### 内部解体

モジュールや部品の個別の  
取り外し



### 分別・廃棄

有害物質の適切な処理  
リサイクル廃材の適切処分



### テクニカル レポート

作業の詳細な記録  
インシデント報告



# AGENDA

- 01 2026年11月期1Q 業績ハイライト
  - 02 中期経営計画サマリ ※2026年1月14日公表
  - 03 事業概要
  - 04 市場環境**
  - 05 競争優位性
- Appendix

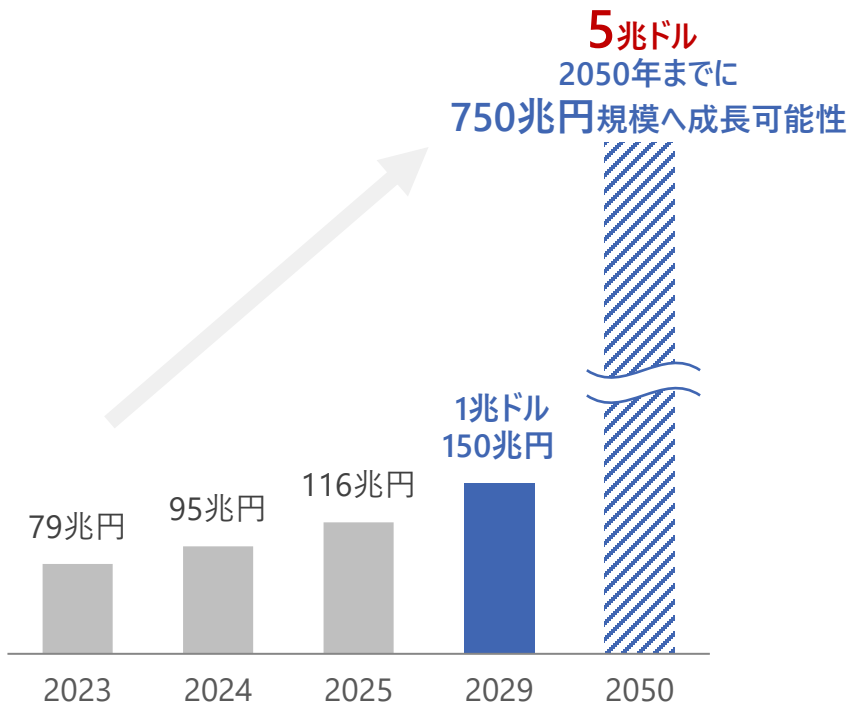
# 世界の半導体市場規模

## 150兆円予測を凌駕する市場ポテンシャルの更なる高まりが、当社の成長戦略を後押し

- 世界の半導体市場は、AI需要に関連した投資が牽引し、2029年までに150兆円（1兆ドル）まで急拡大の見通し  
長期的には、2050年までに750兆円（5兆ドル）まで成長する可能性
- 当社が中長期ターゲット市場と見据える半導体製造装置市場についても順調に拡大

世界の半導体市場予測

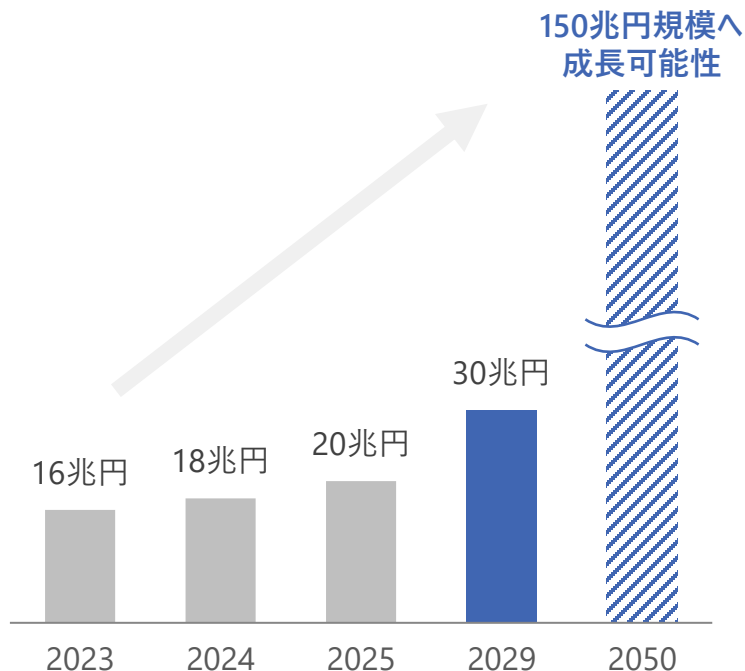
AIに関連し、データセンター投資が牽引  
2026年は前年から26%増と予測



出所：(一社)WSTS日本協議会「WSTS 2025年秋季半導体市場予測について」  
東京エレクトロン(株) コーポレートサイト「The Future of the Semiconductor Industry and its People」  
※150円/USDにて日本円換算後

世界の半導体製造装置市場予測

高性能半導体の需要の増加等を背景に、  
先端製造装置を中心に拡大見込む

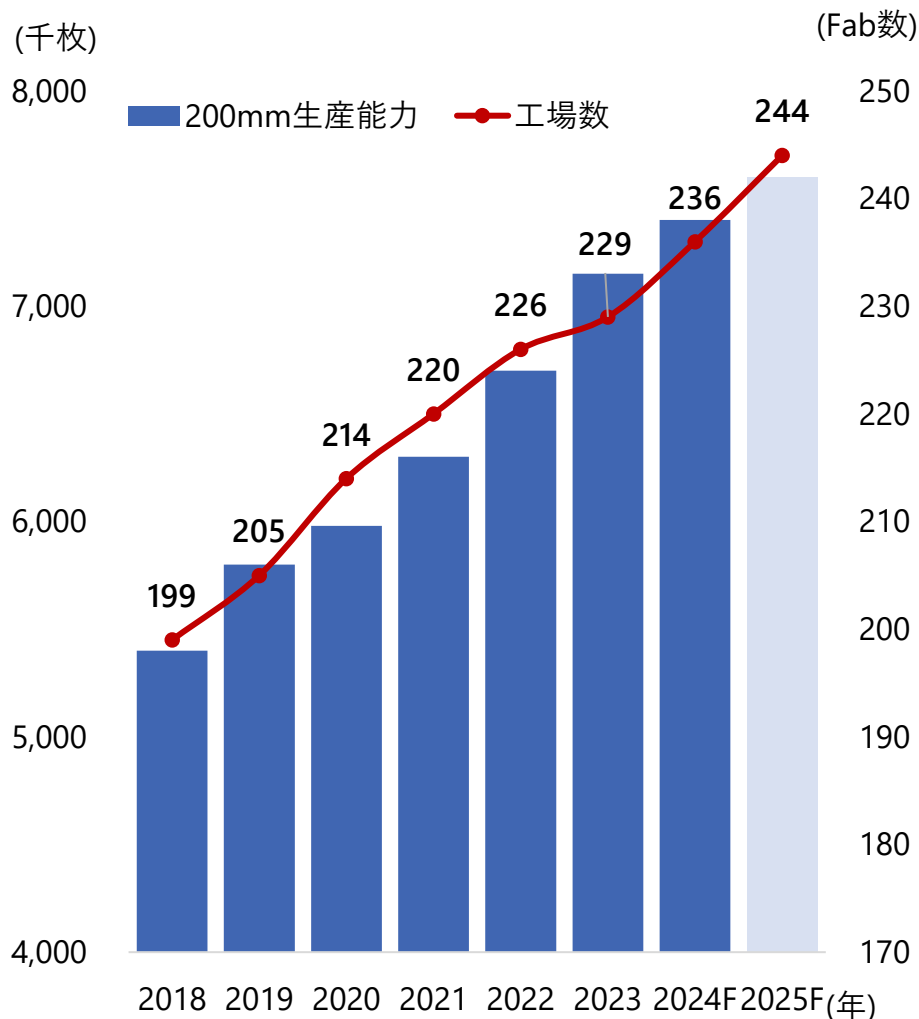


出所：SEMI「世界半導体製造装置の2025年末市場予測発表」を元に試算  
2050年は、半導体市場全体の成長率と同水準で推移するものと仮定し算出  
※150円/USDにて日本円換算後

# レガシー半導体の旺盛

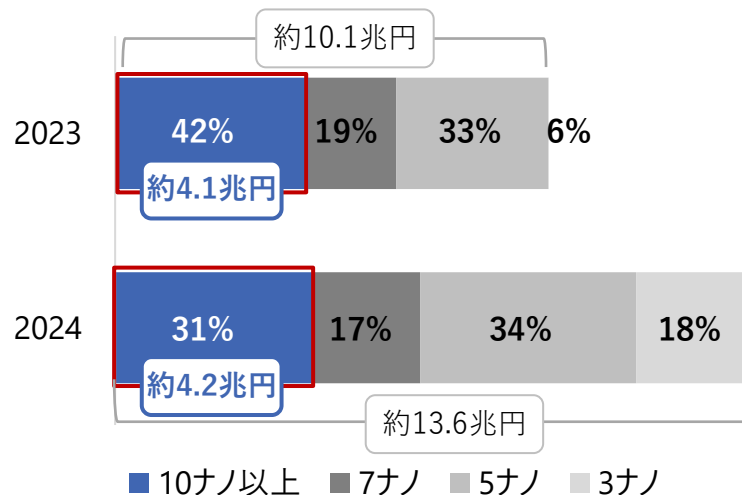
## 半導体不足により200mm工場の生産能力が急成長へ、先端企業でもレガシー半導体は主力

### 200mmウエハーファブ数と生産能力推移



### TSMCのプロセス別売上構成

#### 10ナノ以上の市場は依然として巨大



2023年：1NTD=4.68円、2024年：1NTD=4.73円  
 の為替レートにて日本円の売上高を算出  
 2023年：売上高：約2兆1,000億NTD  
 2024年：売上高：約2兆8,943億NTD

出所：SEMI 2024年9月25日発行、「世界の200mm半導体前工程ファブにおける生産能力の推移」

出所：TSMC 開示資料より当社作成2023年、2024年上期実績

# 世界市場における旧型半導体製造装置の重要性

「最先端装置」だけでなく、多様な用途に適応する「旧型装置」の需要も高い

- 最先端工場への投資が活発である一方、旧型半導体に関する需要も依然として高く、

**旧型半導体製造装置の保守は、最先端半導体開発と同様に重要なテーマである**

## 市場の現状

## 投資動向

### 最先端

生成AI関連の需要旺盛等を背景に、データセンターやスマートフォン等、高性能な最先端半導体の需要は極めて高い状況

国内では官民協力により、TSMC関連投資や、微細化技術の開発など、数兆円規模の投資が進んでいる

国外においても、米国や韓国をはじめ、覇権をめぐる国策としての大規模な投資が活発化

### 旧型

IoT製品や自動車関連などを中心に、旧型半導体が用いられるパワー半導体やセンサー等の需要は高まる一方

低～中程度の性能の半導体の需要も旺盛。これらを担う**20年以上前に投資された半導体製造装置も現役で稼働**している状態であり、国内で稼働している半導体工場の**8割以上がウエハサイズ200mm以下のレガシー工場**である

旧型半導体製造装置は現在も重要性が高く、例えばインドがレガシー工場を中心として包括的に支援するISMを国策として発足するなど、**装置の保守**（EOL部品の調達、修理、中古装置の購入や立上・改善など）に対する**投資がグローバルでなされている**

< 200mm / 300mmウエハサイズ工場について >

半導体チップを製造する材料であるウエハの直径サイズを意味しております

200mmウエハは、過去に広く使われてきた標準的なサイズですが、現在では生産効率の高いより大きな300mmのウエハが主流になっております。200mmウエハを使っている工場は、古い技術を使っていることが多く、レガシー工場と呼ばれることがあります

## ターゲット市場

代理店ビジネスとM&Aにより、ターゲットを20兆円規模の「装置市場全体」へ拡大する

- 既存事業のターゲット市場は、半導体市場のうち、中古半導体装置市場、部品・修理サービス市場である
- 半導体装置代理店ビジネスの開始や、今後見込まれるM&A戦略により、  
中長期的には半導体製造装置市場全体をターゲット市場と見据える

現在：2025年

半導体全体市場

116兆円<sup>\*1</sup>

当社の「新規」  
ターゲット市場

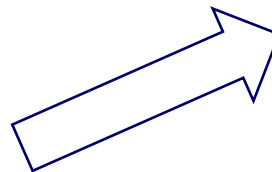
<装置市場全体>

20兆円<sup>\*3</sup>

当社の既存  
ターゲット市場

<中古装置販売>  
<部品・修理サービス>

4.7兆円<sup>\*4,5</sup>



成長ドライバー

- ・市場全体の成長
- ・代理店ビジネス開始
- ・ホワイトスペースM&A
- ・プラットフォーム拡充
- ・グローバル展開加速

未来：2050年

半導体全体市場

750兆円<sup>\*2</sup>

当社の既存  
ターゲット市場

<装置市場全体>

150兆円<sup>\*6</sup>

当社の既存  
ターゲット市場

<中古装置販売>  
<部品・修理サービス>

23.5兆円<sup>\*6</sup>

\*1 出所：(一社)WSTS日本協議会「WSTS 2025年秋季半導体市場予測について」

\*3 出所：SEMI「世界半導体製造装置の2025年末市場予測発表」を元に試算

\*6 2050年は、半導体市場全体の成長率と同水準で推移するものと仮定し算出

\*2 出所：東京エレクトロン(株)コーポレートサイト「The Future of the Semiconductor Industry and its People」

\*4 出所：The Business Research Company「中古半導体装置の世界市場レポート 2025年」 \*5 半導体製造装置市場の20%と仮定

※150円/USDにて日本円換算

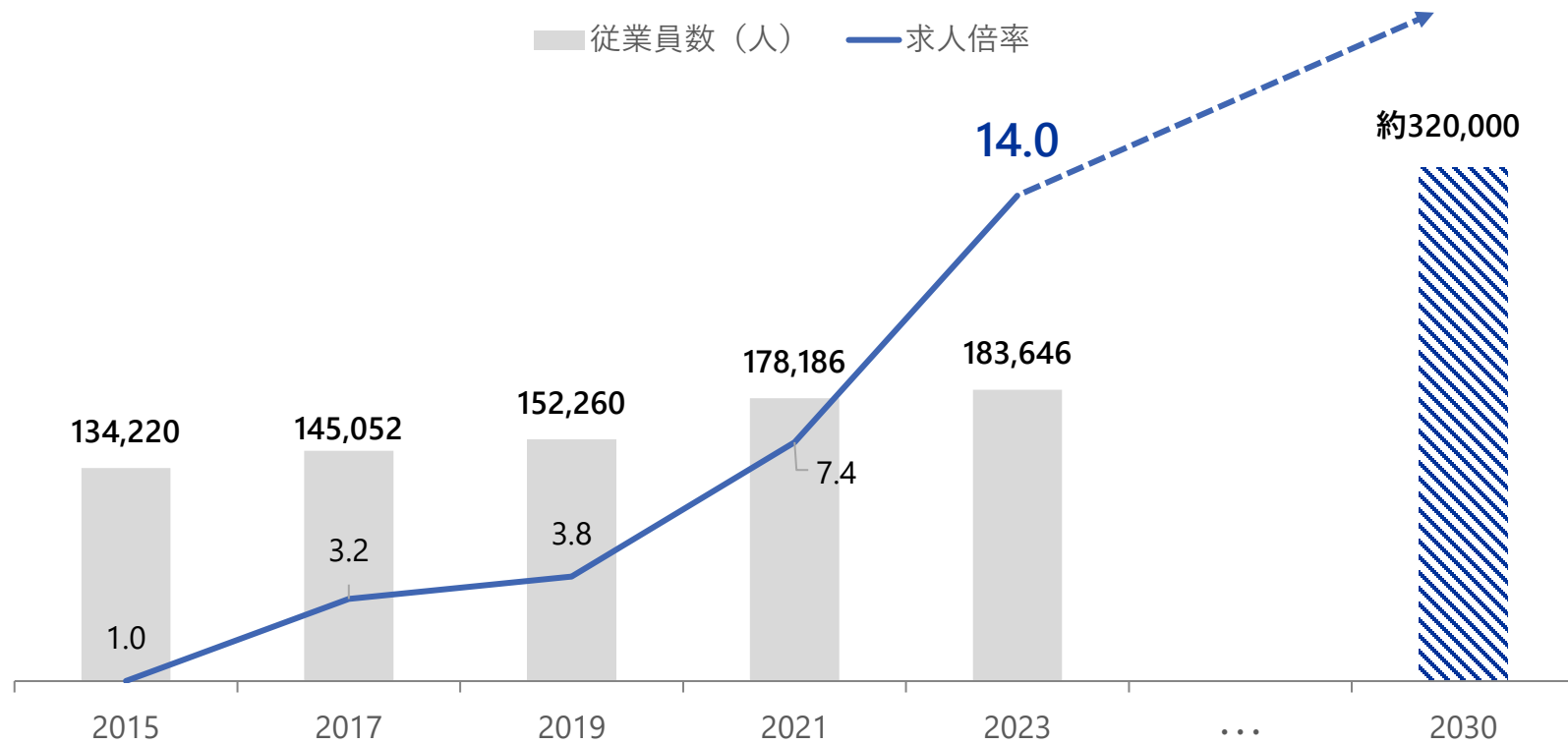
# 国内半導体工場の現状 半導体業界の人手不足

## 半導体業界は深刻な人手不足

- 半導体関連産業の人材数は増加傾向にあるが、**既に人材が不足している状況**であり、求人倍率は著しく上昇
- さらに半導体工場の新規建設等により**2030年までに追加で約14万人が必要**となるとの見解（SEMI）

### 人材供給が半導体関連産業のボトルネックとなりうる

半導体関連産業の人材動向およびエンジニア求人倍率



出所：

\*1 経済産業省「工業統計調査」、「経済構造実態調査」

\*2 日本経済新聞（SEMI幹部「2030年、世界の半導体人材150万人不足」）2024年12月12日記事）

# AGENDA

- 01 2026年11月期1Q 業績ハイライト
  - 02 中期経営計画サマリ ※2026年1月14日公表
  - 03 事業概要
  - 04 市場環境
  - 05 競争優位性**
- Appendix

# 当社の価値源泉

## ①プラットフォーム力及び②エンジニアリング力による製造支援にて価値創出を実現



### 従来のサプライチェーン課題

老朽化装置の部品不足

災害によるサプライチェーンの寸断

不要装置の処理

エンジニア等の人材不足

競争力の低下

半導体製造装置の老朽化

製造イノベーション

### プラットフォーム力

- 装置・パーツ情報供給情報
- 半導体工場の需要情報
- 半導体製造周辺に関連する新規プラットフォーム構築力

### エンジニアリング力

- 装置解体、搬出、設置
- 生産性改善提案
- プロセスチューニング

### TMHの提供する価値

越境EC：調達ルート確保

部品の修理、調達

半導体人材プラットフォーム提供

装置解体/輸出

装置立上/改善

最終製品の機能改善

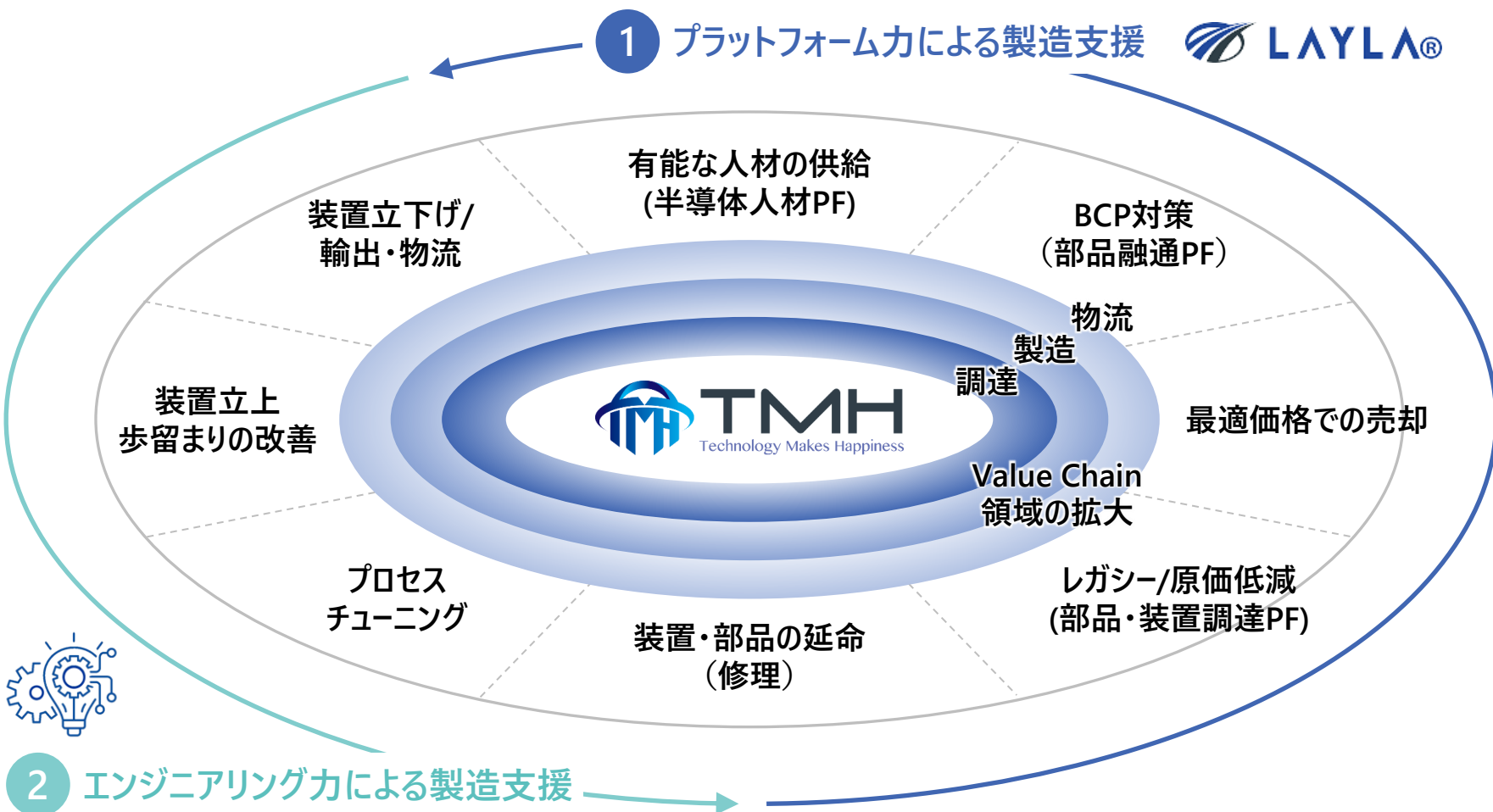
①エンジニアリング力 × ②プラットフォーム力により、顧客の様々な課題を解決

## 企業の収益向上と価値創出を実現

# 技術・知識ナレッジの蓄積

半導体工場の多様な課題に対応することで、顧客にとっての唯一無二の存在に

- 半導体工場の課題解決を通じて様々な案件に触れることにより、ノウハウや課題解決力が向上
- 半導体製造に関わる情報集約型企业として安定的な成長へ



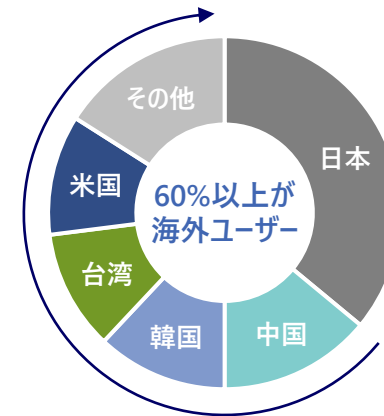
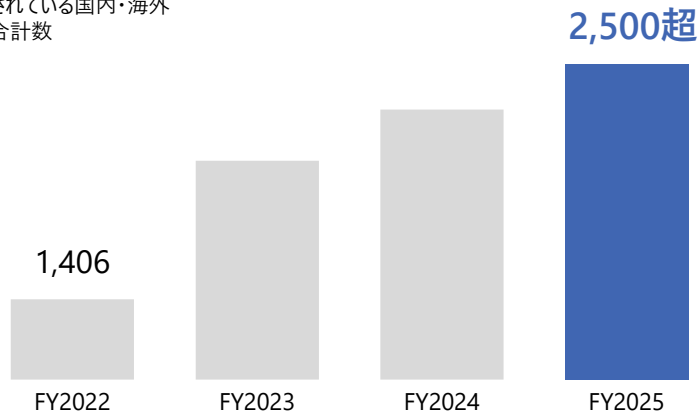
# プラットフォーム力

## LAYLAは半導体業界に不可欠なプラットフォームへ

- LAYLA-ECは、半導体工場にとって重大な課題となっていた部品調達等を解決するプラットフォームとして、グローバルに拡大を続ける
- 国内においても半導体工場の**50%超がLAYLA-ECを導入済み**。国内半導体製造における重要な役割を担う

### グローバルに拡大を広げるユーザー基盤

ユーザーは、LAYLAに登録されている国内・海外全ての購入者・販売者の合計数



### LAYLA-ECがユーザーへ提供するプラットフォーム価値

#### グローバルに広がる調達手段

多言語対応、越境決済、貿易手続等、複雑な越境取引をLAYLA-ECにより容易化

従来調達方法では困難であった越境調達が可能

#### 埋没在庫の可視化

LAYLA-ECを使用することで、世界中の工場に点在する“埋没”している部品等を可視化

レガシー工場にとって最も有効な調達手段として確立

#### ×エンジニアリング力

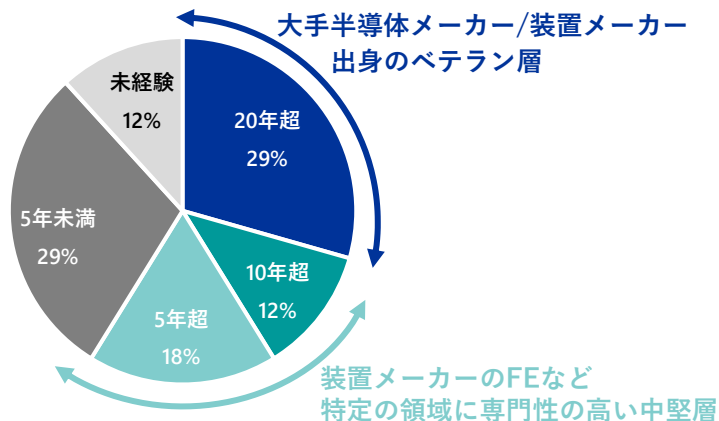
部品等の流通のみではなく、代替品の発掘（目利き）や監査による品質を維持

単なる部品調達ECに留まらないサービスの提供

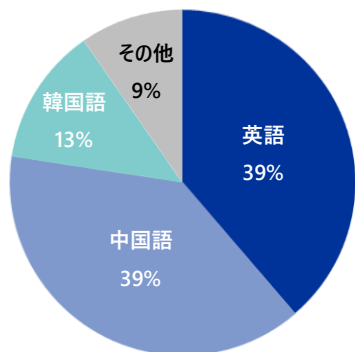
# エンジニアリング力 グローバルで評価される専門家チーム

- 半導体分野のプロフェッショナルが厚く在籍。また、半導体分野の主要各国の言語能力も有し、現地の商慣習にも精通したメンバーを揃えている。
- 調達から立ち上げ、延命、改善まで技術的課題の解決に一気通貫して対応できるエンジニアリング力を発揮  
**世界最大の半導体メーカーからサプライヤーアワードを受賞するなど、グローバルから評価**

## 経験豊富かつ市場に希少なベテラン・中堅層



## 半導体主要各国に関する言語能力



出所：2025年11月末時点（管理部門を除く）

## フィールドエンジニアリング

中古半導体装置の販売を行うのみでなく、解体、搬出（設置）およびプロセスチューニング（装置の最適化）等、「レガシー装置」に熟知したベテラン・中堅エンジニアが、生産性改善から稼働延命まで一気通貫で支援。

## ノウハウの複利効果

グローバルに広がるLAYLAプラットフォームにより、世界中の知見、商慣習、情報を集約。経験豊富なエンジニアとのシナジーにより、競合他社には模倣が困難なエンジニアリング力を実現。

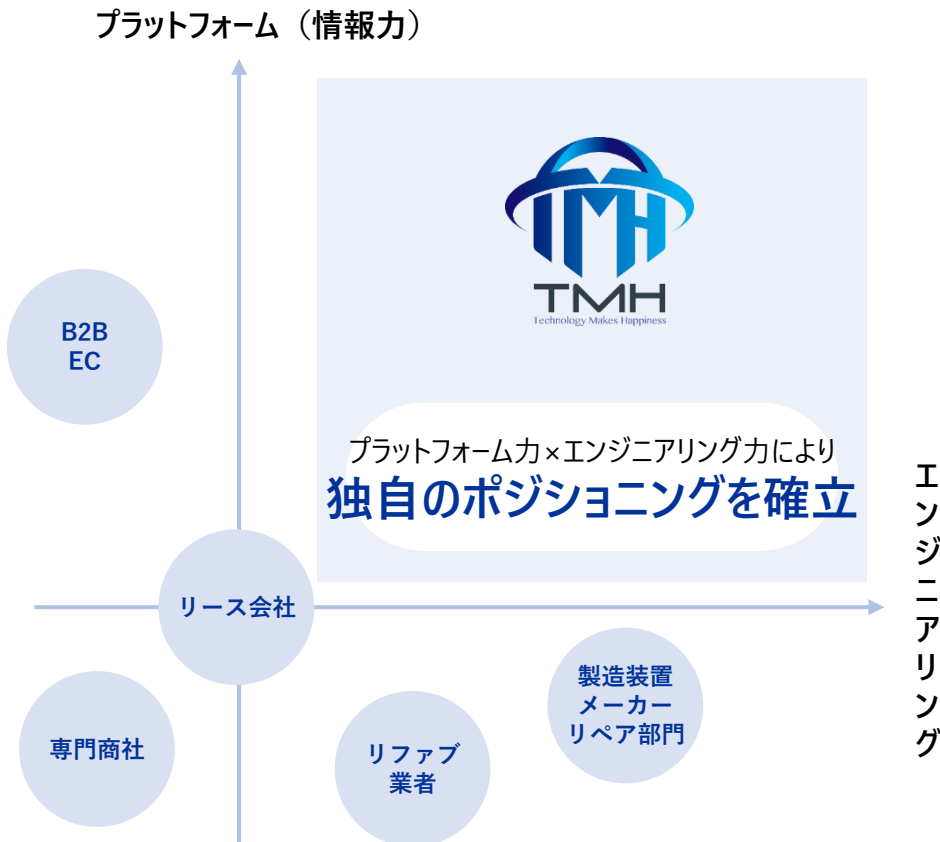
## 目利き力

半導体工場が調達困難な部品等であっても、代替品の可能性や海外も含めてソーシング対応。品質を判断する目利き力により「購入してみたものの期待通りに機能しない」といった、中古部品等の重大リスクを最小限に削減。

# ポジショニングマップ

## 独自のポジショニングを確立し、ニッチトッププレイヤーとしての市場を創造

### 競合と当社のポジショニング比較



### 当社の優位性・参入障壁

#### 01 | エンジニアカによる高付加価値 vs リース会社、商社

- プラットフォームを活用した情報力、高度なエンジニアリング力に基づく知見を有する
- 半導体製造装置の立上げやプロセスチューニングといった高度な支援を提供

#### 02 | レガシー工場、マルチベンダー対応 vs 半導体製造装置メーカー

- 装置メーカーは先端工場に対して支援が厚いが、当社はレガシー工場も含めて広く半導体工場を支援
- 装置メーカーは自社製品を中心に扱うが、当社は全ての製造装置メーカーの商材を扱い、幅広いサービスラインナップを提供

#### 03 | 強固な顧客基盤 vs 新規参入

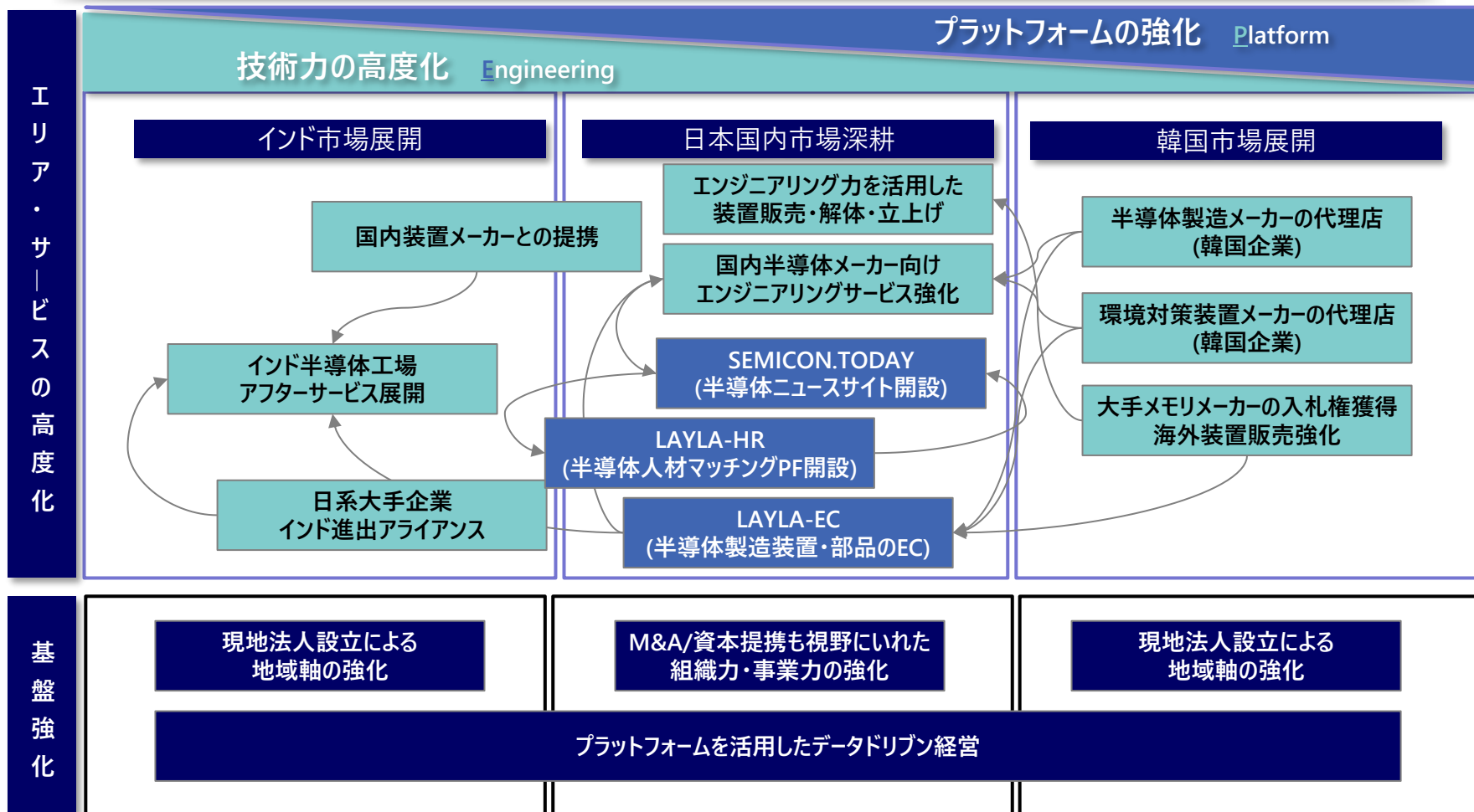
- 半導体製造領域は技術的な知見を必要とし、また当社は、既に日本全国に顧客基盤があり多くのシェアを獲得していることから、参入障壁を高く保持することが可能

中期的なマージンターゲットを実現するための施策

市場・サービス拡大により、売上(流通総額)180億円超、営業利益17.6億円を目指す

売上(流通総額) **180**億円超 営業利益 **17.6**億円

**Aim 2028**



# Appendix

## FY2026業績予想の前提

(単位：百万円)	業績予想額	前提
売上高	6,112	
装置販売	4,104	<ul style="list-style-type: none"> <li>装置販売サービスは、現時点の受注残および販売計画に基づき試算しております。</li> </ul>
部品販売・修理サービス	2,008	<ul style="list-style-type: none"> <li>部品販売・修理サービスは、前年実績および営業活動進捗に基づき試算しております。</li> <li>半導体工場の稼働が増加することで売上も増加する特性があります。</li> </ul>
売上原価	5,109	<ul style="list-style-type: none"> <li>装置販売の利益率により、売上原価及び部品販売・修理サービスの販売額に応じて原価率の変動します。</li> </ul>
販売費及び一般管理費	634	<ul style="list-style-type: none"> <li>前年実績及び増加人員や展開計画にあわせて費用を試算しております。</li> </ul>
営業外損益	営業外収益 8 営業外費用 6	<ul style="list-style-type: none"> <li>前年度実績等に基づき試算しております。</li> <li>為替影響については、基本的に装置販売サービスのような大型案件は円建て取引とすることで為替リスクを極小化しています。</li> <li>また、部品販売・修理サービスは外貨建て取引があるものの、売上計上と入金及び仕入計上と支払のタイミングが近いこと、影響は軽微なものとして想定しております。</li> </ul>

## 本資料の取扱いについて

---

本資料は、株式会社TMH（以下「当社」といいます。）の企業情報等のご案内のみを目的として当社が作成したものであり、当社の有価証券の投資勧誘等を目的としたものではありません。

本資料に記載されている情報は、現時点の経済、規制、市場等の状況を前提としています。本資料には、将来の見通しに関する記述が含まれています。これら将来の見通しに関する記述は、当該記述を作成した時点における情報に基づいて作成されています。これらの記述は、将来の結果や業績を保証するものではありません。

このような将来予測に関する記述には、必ずしも既知および未知のリスクや不確実性が含まれており、その結果、将来の実際の業績や財務状況は、将来予想に関する記述によって明示的または黙示的に示された将来の業績や結果の予測とは大きく異なる可能性があります。

本資料に記載されている当社以外の企業等に関する情報および第三者の作成に係る情報は、公開情報等から引用したものであり、そのデータ・指標等の正確性・適切性等について、当社は独自の検証は行っておらず、何らその責任を負うことはできません。